

台灣夏普股份有限公司 第二屆第3次勞資會議紀錄

時 間：民國112年8月18日（星期五）下午14時00分~15時00分

地 點：新北市土城區中山路16號6樓

出席代表

勞方代表：黃亦聖、胡竣理、陳郁豪、蔡宏璋、王正如

資方代表：張凱傑、董于震、蕭家昕、解天霖

列席人員：無

請假或缺席代表

勞方代表：無

資方代表：廖韋昌(吳景源 代理出席)、解天霖(邱曉瑜 代理出席)

主 席：張凱傑 總經理

紀錄：人資部 甘雅菱

一、報告事項：

- (一) 行事曆公告：參考行政院人事行政局辦公日曆及鴻海2023年8月~11月份行事曆內容制定，說明中秋、國慶連假期間與補班概況，勞方代表皆無異議。
- (二) 新組織公告：因應台灣夏普2023年擴大市占與提升銷售業績目標，進行組織調整，下半年陸續進行商用事業(CBS)BU 成立，於2023/7/1生效；另整合物流相關人力資源，控管、優化倉儲成本費用及流程，提升營運效益。除了品牌、商用事業，TDC 物流倉儲需求，也可以一併加入洽談，爭取更優惠條件。
- (三) 員工動態報告：7月底在職人數共176位(正職164位，約聘2位，派遣10位)。離職人數(1~7月)共24位。
- (四) 業務概況報告(品牌事業 STE、裝置事業 TDC、商用事業 CBS)：
 1. 品牌(B2B)與商用(B2C)事業目標，今年度修正為30億。商用事業目前著重擴大顯示器解決方案的業務、教育局合作專案，期望以業績目標達到90%，盡快彌補支出。
 2. TDC 業績目標25億，主力放在 NB Gaming、新應用(AI/充電樁/元宇宙)市場。
- (五) 薪資方案說明：台灣夏普與可購樂全體同仁適用年終獎金保障2個月(新

任職第1年之年終獎金，按照當年度在職天數比例計算)。

- (六) 2023福利一覽表公告暨線上申請作業說明：福委會於5月份公告「台灣夏普福利一覽表」與 Swork 系統申請流程。完整內容與資格條件可到 EIP→職福會專區查詢。針對福利項目內容有疑問可洽各單位福委。

二、討論事項：

(一) 第一案：第2屆第4次勞資會議日期

說 明：依照勞資會議實施辦法，勞資會議至少每三個月舉辦一次。

決 議：暫訂於2023/11/22(三)，如有異動再另行討論。

三、建議事項（臨時動議）：

- (一) 本次會議共提出下列類別相關事項建議，膳食與環境類將請震旦服務部-溫經理，研擬改善提案。資訊系統類由 STE 資訊部進行內部討論。

1. 福利事項：是否包含頂埔廠刷餐，主委與主席回覆，應為廠區便利商店商品折扣，非「刷餐」，刷餐達到一定次數時，鴻海將認定人員工作廠區非中山16，並收取相關總務費用分攤金額。

2. 膳食：(1)增加素食餐點內容的說明，以利同仁選擇。(2)週五餐點選項可有不同選擇。(3)期望每周一/二的餐點品質能改善。

3. 環境：(1)改善空調出風口風量/風向。(2)加強7F 女廁清潔。(3)7F 會議室空間稍嫌不足，評估增加隔間。

4. 作業流程 e 化，減少人工繁複作業與內/外網系統整合，降低使用不便。

四、散會：下午15時00分

主席：(簽名)

范錦修
8/21/23

紀錄：(簽名)

解天祿
8/21/23

甘雅菱
8/21/23